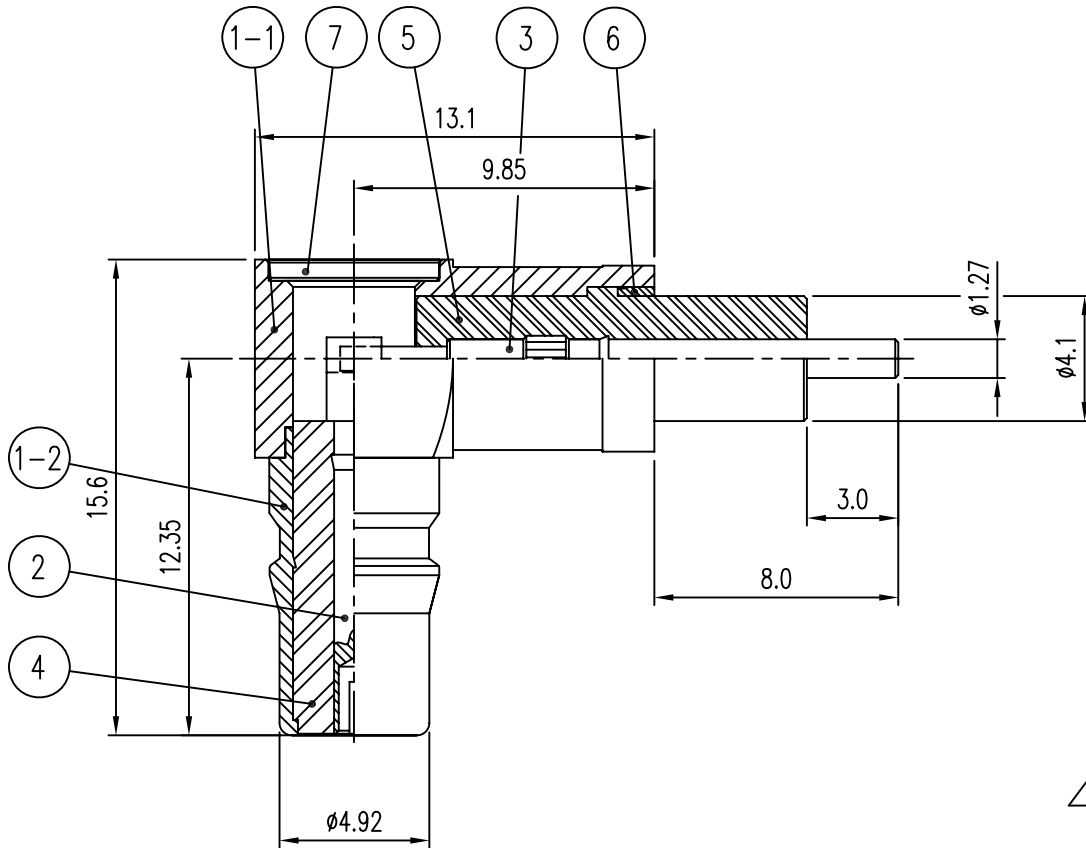


ST	가공											수 정 내 용				
												부호	내 용	수정자	승인자	년 월 일
ST(기초)												1	(첨변No.201504-0006) BODY 표준화 치수 변경 및 P/N, TEFLON 치수 변경	H.J.LEE	I.C.KIM	2015. 04. 16.
ST(개선)												2	(설번No.201806-0002) QMA 표준화 치수 변경	S.Y.EUN	I.C.KIM	2018. 06. 08.



7	COVER	1	MBsBD	Nickel Plate	DCV00038-5/2	
6	COVER	1	MBsBD	Nickel Plate	DCV00037-5/2	
5	INSULATOR	1	TEFLON		DIN01077-N/1	
4	INSULATOR	1	TEFLON		DIN01265-N/2	
3	CONTACT	1	MBsBD	Gold Plate	DCT01488-5/1	
2	CONTACT	1	BeCu	Gold Plate	DCT01487-5/2	
1	1-2 BODY (B)	1	MBsBD	Nickel Plate	DBB00145-5/4	DBD01953-1/2
	1-1 BODY (A)	1	MBsBD	Nickel Plate		DBD01952-3/2

대체가능재질	품번	품 명	수량	재 질	표면처리	비 고
공통공차 * ±0.1 ** ±0.05	년월일 2018. 06. 08.			 RF & MICROWAVE TECHNOLOGY Tel : 82-32-347-8015 Fax : 82-32-347-8017 KJ COMTECH CO.,LTD.		
	승인	I.C.KIM				
재질	검도	도명 KQMA50 SOLDER END JL-2H				
	재도					
열처리	작성부서 연 구 소			A4	도번 CN01969-7/4	
보호파막처리	적도 4/1	단위 mm	중량			

A4